

ROBUSTNESS VALIDATION

Risikobewertung (ISO 26262)
neuer Technologien und Consumer
Bauteile in KFZ-Elektronik



BEIDE TAGE SIND
GETRENNT BUCHBAR

**Vielfältige
Austauschmöglichkeiten**
insbesondere durch
die Abendveranstaltung

Thematische
mit den Referenten
in den Pausen

Visitenkartenaustausch
zu Beginn der Konferenz

Mindtrigger
Wir versorgen Sie vor
und nach der Konferenz
mit wichtigen aktuellen
Informationen, Denk-
anstößen, Impressionen
und Nachlesen



| 1 Vorsitz: Dipl.-Ing. Helmut Keller, ZVEI Robustness Validation Forum / SAE Automotive Electronics Reliability Committee
| 2 Dipl.-Physiker Jürgen Gruber, RoodMicrotec GmbH | 3 Harald Grübel, Consulting4Drive GmbH
| 4 Werner Kanert, Infineon Technologies AG | 5 Stefan Kriso, Robert Bosch GmbH



| 6 Dr. Zhongning Liang, NXP Semiconductors | 7 Klemens A. Molinari, Consulting4Drive GmbH
| 8 Alexander Nebeling, Delphi Deutschland GmbH | 9 Dr. Stefan Poledna, TTTech
| 10 Andreas Preussger, Infineon Technologies AG



| 11 Andreas Reuter, Reusch Rechtsanwälte | 12 Peter de Place Rimmen, Danfoss Power Electronics A/S
| 13 Rene Rongen, NXP Semiconductors | 14 Dr.-Ing. Rolf Schlagenhaf, Freescale Halbleiter Deutschland GmbH
| 15 Jörg Michael Schneider, NXP Semiconductors



| 16 Walter Schock, Tec Support Quality Engineering UG | 17 Josef Stockinger, STMicroelectronics Application GmbH
| 18 Dr. Michael Stoll, OSRAM Opto Semiconductors GmbH | 19 Dr. Georg Tempel, Infineon Technologies Dresden GmbH
| 20 Uwe Thiemann, RoodMicrotec GmbH

EUROFORUM
Quality in Business Information

KONFERENZ

4. und 5. November 2014, Hilton Hotel, Düsseldorf

4. November 2014

GRUNDSATZFRAGEN / MANAGEMENT



Dipl. Ing. Helmut Keller, Consulting & Engineering Services ZVEI Robustness Validation
Forum Spokesman SAE Automotive Electronics
Reliability Committee Chairman Europe

VORSITZ

9.00–9.30

Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen

BUSINESSCARD SWAP

Wir geben Ihnen zu Beginn der Veranstaltung die Möglichkeit zum Austausch Ihrer Visitenkarten. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Kolleginnen und Kollegen in Kontakt zu treten und sich zum Thema auch nach der Veranstaltung auszutauschen.



9.30–9.45

Begrüßung durch den Vorsitzenden und Einführung in das Thema „Robustness Validation“

Dipl. Ing. Helmut Keller

9.45–10.15

Halbleiter im Auto-Limitierung oder Chance im globalen Wettbewerb?

- Elektronik im Auto – Marktbetrachtung und Wertschöpfung
- Kundennutzen und Nutzungsverhalten, auch im Vergleich zu anderen Industrien
- Szenarien mit wirtschaftlicher, rechtlicher und technologischer Bewertung
- Ist-Situation OEMs und TIERS, Lösungsstrategien und Chancen



Harald Grübel, President & CEO, Consulting4Drive GmbH und **Klemens A. Molinari**, Senior Consultant, Consulting4Drive GmbH

10.15–10.45

Funktionale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit: Widerspruch oder Ergänzung

- Grenzen der Funktionalen Sicherheit ohne Bezugnahme auf Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit
- Verschiebung der Kundenerwartungen und daraus resultierende Anforderung an die Entwicklung
- Integrale Betrachtung von Sicherheit und Zuverlässigkeit



Dr. Stefan Poledna,
Mitgründer und Vorstandsmitglied, TTech

10.45–11.00 Fragen und Diskussion

11.00–11.30 Pause mit Kaffee und Tee

... mit den Referenten der vorangegangenen Themen

THEMEN
TISCHE

11.30–12.00

Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Consumer-Bauteilen für automotive Anwendungen

- Kategorien und Charakteristiken von Consumer-Bauteilen und -Anwendungen
- Kategorien und Anforderungen
- Erfahrungen beim Einsatz von Consumer-Bauteilen im Auto
- Maßnahmen zur Anpassung von Consumer-Bauteilen an die Anforderungen im Auto



Josef Stockinger, Emerging/New Automotive Applications
EMEA Region – APG Marketing and Application,
STMicroelectronics Application GmbH

12.00–12.30

Consumer und Automotive – Koexistenz wird zur Symbiose

- Consumer und Automotive – vom Nebeneinander zum Miteinander
- Anforderungen in ADAS Anwendungen
- Consumer Komponenten in Automotive Anwendungen



Jörg Michael Schneider, Director Automotive Customer
Communication, NXP Semiconductors

12.30–12.45 Fragen und Diskussion

12.45–14.00 Gemeinsames Mittagessen

... mit den Referenten der vorangegangenen Themen

THEMEN
TISCHE

14.00–14.30

Neue Technologietrends und deren Auswirkungen auf Qualität und Zuverlässigkeit

- Zuverlässigkeitstrends auf Technologie-Ebene
- Zuverlässigkeitstrends auf Produkt- Ebene
- Zuverlässigkeit durch Design



Dr. Andreas Preussger,
Director Quality Management, Infineon Technologies AG

14.30–15.00

Qualifikation neuer Technologien: AEC Q10x und Robustness Validation im Vergleich

- Erklärung von RV Flow Charts in Q10x
- Anwendung auf neue Technologien
- Beispiel: Cu-Draht



Rene Rongen,
Reliability Competence Manager, NXP Semiconductors